



# Initial Product/Process Change Notification

Document #: IPCN24252X

Issue Date: 14 Sep 2021

|  |  |
|--|--|
| <b>Title of Change:</b>                          | C13C (MT9V*) CLCC assembly transfer from THEPI to Kingpak  |
| <b>Proposed First Ship date:</b>                 | 11 Apr 2022 or earlier if approved by customer   |
| <b>Contact Information:</b>                      | Contact your local onsemi Sales Office or <a href="mailto:Geethakrishnan.Narasimhan@onsemi.com">Geethakrishnan.Narasimhan@onsemi.com</a>   |
| <b>PCN Samples Contact:</b>                      | Contact your local onsemi Sales Office or < <a href="mailto:PCN.samples@onsemi.com">PCN.samples@onsemi.com</a> >. Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.  |
| <b>Type of Notification:</b>                     | This is an Initial Product/Process Change Notification (IPCN) sent to customers. An IPCN is an advance notification about an upcoming change and contains general information regarding the change details and devices affected. It also contains the preliminary reliability qualification plan. The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPCN notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact < <a href="mailto:PCN.Support@onsemi.com">PCN.Support@onsemi.com</a> > |
| <b>Marking of Parts/ Traceability of Change:</b> | Marking and Date Code  |
| <b>Change Category:</b>                          | Assembly Change  |
| <b>Change Sub-Category(s):</b>                   | Manufacturing Site Transfer  |

**Sites Affected:**

| onsemi Sites | External Foundry/Subcon Sites                   |
|--------------|---|
| None         | Kingpak, Taiwan                                 |
|              | Tong Hsing Electronic Inc. (THEPI), Philippines |

**Description and Purpose:**

THEPI has issued end of life for C13C (MT9V\*) CLCC package assembly and test at its location. In order to prevent supply disruption, this product is being transferred and qualified in Kingpak, Taiwan. The final test, which was dual sourced at THEPI and KYEC (Taiwan), will now continue to be supported at KYEC. Below is the summary of proposed changes in manufacturing sites for C13C CLCC assembly and test. There is no change in final test program or test limits. The proposed changes will be qualified and verified to current datasheet specifications.

|                      | Current                  | Proposed              |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| C13C CLCC Assembly   | THEPI                    | Kingpak, Taiwan       |
| Gold Wire            | Nippon T3 Au Wire 1.0mil | Tanaka Au Wire 0.8mil |
| C13C CLCC Final Test | THEPI and KYEC, Taiwan   | KYEC, Taiwan          |

There is a product marking change as a result of the proposed changes. The change in marking will be shown in the FPCN (Final Product Change Notification) which will be distributed in Jan 2022.



# Initial Product/Process Change Notification

Document #: IPCN24252X

Issue Date: 14 Sep 2021

## Qualification Plan:

The CLCC assembly transfers will be qualified based on the qualification plan shown below.

**QV DEVICE NAME : MT9V034C12STM-DR**

**PACKAGE : CLCC**

| Test | Specification    | Condition                                  | Interval   |
|------|------------------|--|------------|
| PC   | J-STD-020        | 30°C/60%RH for 96hrs + 3X IR Reflow @ 245C | -          |
| TC   | JESD22-A104      | -55°C - 125°C                              | 500 cycles |
| THS  | JEITA ED4701-100 | 60°C/90% RH with no bias                   | 1008 hrs   |
| HTSL | JESD22-A103      | Ta= 150°C                                  | 504 hrs    |
| SD   | J-STD-002        | Solderability                              | -          |
| MST  | J-STD-020        | Moisture Sensitivity Test                  | -          |
| WBP  | JESD22-A114      | Wire Bond Pull                             | -          |
| WBS  | JESD22-C101      | Wire Bond Shear                            | -          |

Estimated date for qualification completion: 20 January 2022

## List of Affected Parts:

**Note:** Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [PCN Customized Portal](#).

| Part Number       | Qualification Vehicle |
|-------------------|-----------------------|
| MT9V034C12STC-DR  | MT9V034C12STC-DP1     |
| MT9V034C12STM-DP1 | MT9V034C12STC-DP1     |
| MT9V034C12STM-DP  | MT9V034C12STC-DP1     |
| MT9V034C12STM-DR1 | MT9V034C12STC-DP1     |
| MT9V034C12STM-DR  | MT9V034C12STC-DP1     |
| MT9V034C12STM-TP  | MT9V034C12STC-DP1     |
| MT9V034C12STC-DP  | MT9V034C12STC-DP1     |
| MT9V034C12STC-DP1 | MT9V034C12STC-DP1     |

Japanese translation of the notification starts here.  
通知の日本語訳はここから始まります。

*Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。

|   |  |                       |
|---|--|-----------------------|
| <b>変更件名:</b>  | C13C (MT9V*) CLCC の組み立てを THEPI から Kingpak に移転  |                       |
| <b>初回出荷予定日:</b>   | 2022 年 4 月 11 日またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前   |                       |
| <b>連絡先情報:</b>   | 現地のオンセミ営業所または < <a href="mailto:Geethakrishnan.Narasimhan@onsemi.com">Geethakrishnan.Narasimhan@onsemi.com</a> > にお問い合わせください。  |                       |
| <b>サンプル:</b>  | 現地のオンセミ営業所または < <a href="mailto:PCN.Samples@onsemi.com">PCN.Samples@onsemi.com</a> > にお問い合わせください。<br>サンプルは、この変更の初回 PCN または最終 PCN の最初の通知の日付から 30 日以内に要求してください。<br>サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。   |                       |
| <b>通知種別:</b>  | これは、お客様宛の初回製品 / プロセス変更通知 (IPCN) です。IPCN は、近日中に実施される変更に関する事前通知であり、変更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般情報が記載されます。また、暫定的な信頼性認証計画も記載されます。<br>最終的な認定データおよび特性データは最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれます。この IPCN は、変更実施から少なくとも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に先だって通知されます。ご不明な点がありましたら、< <a href="mailto:PCN.Support@onsemi.com">PCN.Support@onsemi.com</a> > にお問い合わせください。 |                       |
| <b>部品のマーキング/変更のトレーサビリティ:</b>  | 表示とデートコード  |                       |
| <b>変更カテゴリ:</b>  | 組立の変更  |                       |
| <b>変更サブカテゴリ:</b>  | 製造拠点の移転  |                       |
| <b>影響を受ける拠点:</b>  |  |                       |
| <b>オンセミ拠点:</b>  | <b>外部製造工場 / 下請業者拠点:</b>  |                       |
| なし  | Kingpak, Taiwan  |                       |
|   | Tong Hsing Electronic Inc. (THEPI), Philippines  |                       |
| <b>説明および目的:</b>   |  |                       |
| <p>THEPI は C13C (MT9V*) CLCC パッケージの組立およびテストを終了する旨を発表しました。供給を維持するため、この製品は今後、台湾の KINGPAK で組み立てられ、認定されることとなります。THEPI と KYEC (台湾) の 2 拠点にて実施されてきた最終テストは、KYEC で引き続き実施されることとなります。C13C CLCC の組立・テスト拠点を変更する提案の概要は以下のとおりです。最終テストプログラムまたはテスト限界値に変更はありません。提案された変更は現行のデータシート仕様で認定および検証されます。</p> |  |                       |
|   | <b>現行</b>  | <b>変更案</b>            |
| C13C CLCC 組立  | THEPI  | Kingpak, Taiwan       |
| 金ワイヤ  | Nippon T3 Au Wire 1.0mil   | Tanaka Au Wire 0.8mil |
| C13C CLCC 最終テスト   | THEPI and KYEC, Taiwan   | KYEC, Taiwan          |
| <p>今回の変更に伴う製品表示の変更はありません。</p> <p>提案された変更に伴う製品表示の変更があります。表示の変更は 2022 年 1 月に配布予定の FPCN (最終製品変更通知) に記載されます。</p>  |  |                       |

**認定計画:**

CLCC 組み立て移転は、以下に記載される認定計画に基づいて認定されます。

デバイス名: MT9V034C12STM-DR

パッケージ: CLCC

| テスト  | 規格               | 条件   | 間隔         |
|------|------------------|--|------------|
| PC   | J-STD-020        | 30°C/60%RH for 96hrs + 3X IR Reflow @ 245C | -          |
| TC   | JESD22-A104      | -55°C - 125°C                              | 500 cycles |
| THS  | JEITA ED4701-100 | 60°C/90% RH with no bias                   | 1008 hrs   |
| HTSL | JESD22-A103      | Ta= 150°C                                  | 504 hrs    |
| SD   | J-STD-002        | Solderability                              | -          |
| MST  | J-STD-020        | Moisture Sensitivity Test                  | -          |
| WBP  | JESD22-A114      | Wire Bond Pull                             | -          |
| WBS  | JESD22-C101      | Wire Bond Shear                            | -          |

認定完了予定日 : 20 January 2022

**影響を受ける部品の一覧:**

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

| 部品番号              | 認定試験用デバイス         |
|-------------------|-------------------|
| MT9V034C12STC-DR  | MT9V034C12STC-DP1 |
| MT9V034C12STM-DP1 | MT9V034C12STC-DP1 |
| MT9V034C12STM-DP  | MT9V034C12STC-DP1 |
| MT9V034C12STM-DR1 | MT9V034C12STC-DP1 |
| MT9V034C12STM-DR  | MT9V034C12STC-DP1 |
| MT9V034C12STM-TP  | MT9V034C12STC-DP1 |
| MT9V034C12STC-DP  | MT9V034C12STC-DP1 |
| MT9V034C12STC-DP1 | MT9V034C12STC-DP1 |

**Appendix A: Changed Products**

**PCN#: IPCN24252X**  
**Issue Date: Sep 14, 2021**

| Product           | Customer Part Number | Qualification Vehicle | New Part Number | Replacement Supplier |
|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| MT9V034C12STC-DR  |                      | MT9V034C12STC-DP1     | NA              |                      |
| MT9V034C12STM-DP1 |                      | MT9V034C12STC-DP1     | NA              |                      |
| MT9V034C12STM-DR  |                      | MT9V034C12STC-DP1     | NA              |                      |
| MT9V034C12STC-DP1 |                      | MT9V034C12STC-DP1     | NA              |                      |